



深圳市福英达工业技术有限公司  
SHENZHEN FITECH CO., LTD.

## 合金焊粉产品规格书

产品名称： 铋基合金焊粉

产品型号： FH260

Web: [www.szfitech.com](http://www.szfitech.com) TEL: 86-0755-26690898 FAX: 86-0755-26820233

广东省深圳市宝安区松岗街道东方社区松岗东路 6 号 8 栋

## 一、适用范围

本规格书主要介绍适用于锡基无铅焊料 FH260 型号产品。

## 二、引用标准

SJ/T 11391-2019 电子产品焊接用锡合金粉

IPC J-STD-005A 锡膏的要求

IPC-TM-650 测试方法手册

## 三、产品成分

### 1.主元素

主元素%		
Bi	Ag	添加物
余量	2.5±0.2	3.0±0.2

### 2.杂质元素

杂质元素 max%								
Pb	Cu	Sb	Cd	Fe	Ni	Zn	Al	As
0.03	0.03	0.03	0.002	0.02	0.01	0.001	0.001	0.03

### 3.RoHS 标准

RoHS max%					
Pb	Cd	Hg	Cr6+	PBB 多溴联苯	PBDE 多溴二苯醚
<300ppm	<20ppm	不含	不含	不含	不含

## 四、焊料物理特性

熔点℃	270	比重 g/cm <sup>3</sup>	9.8
导电率% of IACS	8.0	抗拉强度 MPa	-

## 五、产品性能规格

项目	T3		T4	
外观	灰色粉末		灰色粉末	
球形度	≥95%		≥95%	
粒度	>50μm	<0.5%	>45μm	<0.5%
	45-50μm	<1.0%	38-45μm	<1.0%
	25-45μm	≥90%	20-38μm	≥90%
	<25μm	<10%	<20μm	<5%
氧量	≤100ppm		≤120ppm	

项目	T5(10-25μm)		T6 (5-20μm)	
外观	灰色粉末		银灰色粉末	
球形度	≥95%		≥95%	
粒度 IPC J-STD-005A	>30μm	<0.5%	>25μm	<0.5%
	25-30μm	<5%	20-25μm	<5%
	10-25μm	≥90%	5-20μm	≥90%
	<10μm	<5%	<5μm	<10%
氧量	≤150ppm		≤400ppm	

## 六、产品检测设备及检测方法

检测项目	检测仪器设备	检测方法
成分	斯派克直读光谱仪	IPC-TM-650
成分	原子吸收光谱仪	GB/T 10574.1-13-2003 GB/T 3260.1-11-2000
球形度	电子显微镜/SEM	SJ/T 11391-2009. B
粒度	标准筛	IPC-TM-650 2.2.14
粒度	激光粒度分析仪	激光衍射法
氧含量	氮氧分析仪	SJ/T 11391-2009. C

## 七、产品保质期

应密封储存在室温下（温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\leq 50\% \text{RH}$ ），保质期：6个月。

#### 八、产品检测报告

每个生产批号都按照成分粒度球形度氧含量的检查顺序，进行试验，它的结果记载在产品  
质量报告书上，在产品交纳时一起附上。

#### 九、产品包装要求

1Kg/袋，5Kg/袋，25Kg/桶，客户特殊要求时按客户要求包装。

#### 十、注意事项

1. 室温下保存，禁止阳光下暴晒；
2. 使用时，作业环境有温湿度控制，拌膏下粉前锡粉温度须小于  $25^{\circ}\text{C}$ ；
3. 为了保持良好的焊接效果，建议选择合适的助焊剂、焊接设备及温度。

#### 十一、物质安全数据表（见物质安全数据表 MSDS）

#### 十二、生效日期：2023-11-01